

2012年(平成24年)1月16日(月曜日)

日 刊



発行所 電波新聞社

東京本社  
東京都品川区東五反田1-11  
〒141-8715  
☎03(3445)6111(大代表)

大阪本社  
大阪市中央区北區3-2-25  
(京阪御堂筋ビル6階) 〒541-0041  
☎06(6203)3361(大代表)

西部本社  
福岡市博多区博多駅前2-13  
23(扇寿ビル) 〒812-0011  
☎092(431)7411(大代表)

©電波新聞社 2008

## 千住金属工業

# 世界市場ではんだを拡大

## 用途別の製品開発を強化

千住金属工業は、フラックス製品、低銀はんだ材料、マイクロボールなど、用途に応じたはんだ製品ビジネスをグローバル市場で拡大する。長谷川永悦社長は、12年のビジネスについて「暗い話が多いが、こうした時期こそ顧客のニーズに対応した開発をさらに強化して、少しでも明るい話題を作り出したい。スマートフォンなどデジタル製品はますます軽薄短小、高密度化がさらに進む。用途に応じた製品開発を強化する」と語る。



長谷川 社長

半導体実装に向けたフラックス製品は、炉を汚さず

水で洗浄できる低揮発フラックス、洗浄工程を省略する無残渣フラックス、低価格CuOSP基板でも良好な濡れ性を約束する各種フラックス、フリップチップ実装でのソルダボール凹みを解決するフラックスなどを多様にそろえている。

スマートフォンに代表されるモバイル機器用として「耐落下衝撃性に優れたソルダボールM61」や、は

んだ量が不足するパッドやスルーホール部に「接合補強するチップソルダー」を、車載用やパワーモジュールに「耐熱疲労特性に優れたソルダペーストM53やソルダボールM60」など品ぞろえを充実する。

### 高まる低銀化ニーズ

はんだの低銀化について長谷川社長は「銀価格の高騰から低銀化のニーズは確実に高まっている。中国でも需要が伸びている。当社も世代リフロー実装用低銀ソルダーペーストを開発、市場に出している」とする。

微量なBi、Inなどの添加で、接続信頼性の向上と低融点化を図った結果、

A g含有率の低下にもかかわらず、従来の3% A g (M705) はんだと同等以上の耐熱疲労性を実現し、温度上昇も一般的な3元系SnAgCu系低A g はんだよりも低く抑えた。全てのバランスに優れた

1% A gの「M40」と、よりコストパフォーマンスに優れる0.3% A gの「M46」合金に、汎用フラックス「LS720」と、ハロゲンフリーフラックス「LS720HF」を組み合わせた低銀シリーズで製品化している。

半導体のパンパ形成や、半導体パッケージ部品内の集積回路の接続に用いられるマイクロボールビジネスも強化している。

長谷川社長は「半導体パッケージにおいてもワイヤボンディングからソルダーボール接続へと移行し、さらなる高密度化が進んでいることから、需要の拡大を期待している。宮崎工場(千住技研)でマイクロボールの量産体制を整えた。ボール径が100μmから最小20μmまでの技術を開発している」という。

グローバル化にも積極的に対応している。

長谷川社長は「スマート社会に向けて、はんだ市場はますます拡大するものと期待している。個々のニーズにしっかりと対応していく。ブラジルの市場調査も始めた。中国の市場は大きい。惠州工場ではやい入りを生産しているが、パウダーも生産する。営業拠点も四川省を中心に内陸部の強化を図る」と取り組んでいる。